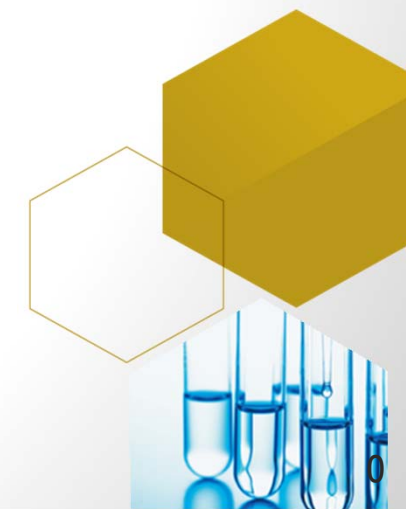
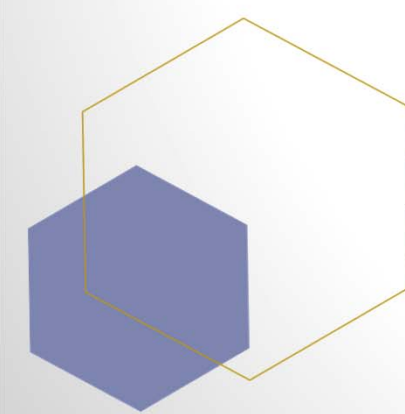



2018年3月期 決算説明資料



 日本高純度化学株式会社

証券コード: 4973

2018年4月24日



2018年3月期 第4四半期の概況

電子部品業界の状況

- スマートフォン市場の飽和状態に伴い需要の鈍化傾向が見受けられた。
- 産業機械ならびに自動車関連市場については引き続き拡大しており、電子部品需要が好調に推移した。

当社決算の概況

- ワイヤーボンディング用純金めっき薬品の販売は、メモリー向け半導体需要に支えられて好調に推移した。
- パッケージ用無電解めっき薬品についても同様に好調に推移した。
- コネクタ用硬質金めっき薬品の販売については、車載向けや産業機械向けの部品需要が引き続き好調に推移し、堅調に売り上げを支える結果となった。
- リードフレーム用パラジウムめっき薬品の販売については、継続して旺盛な部品需要に支えられ好調に推移した。また、貴金属パラジウム相場の高騰に伴い販売価格を押し上げる結果となった。

2018年3月期 決算概況

(単位:百万円、%)

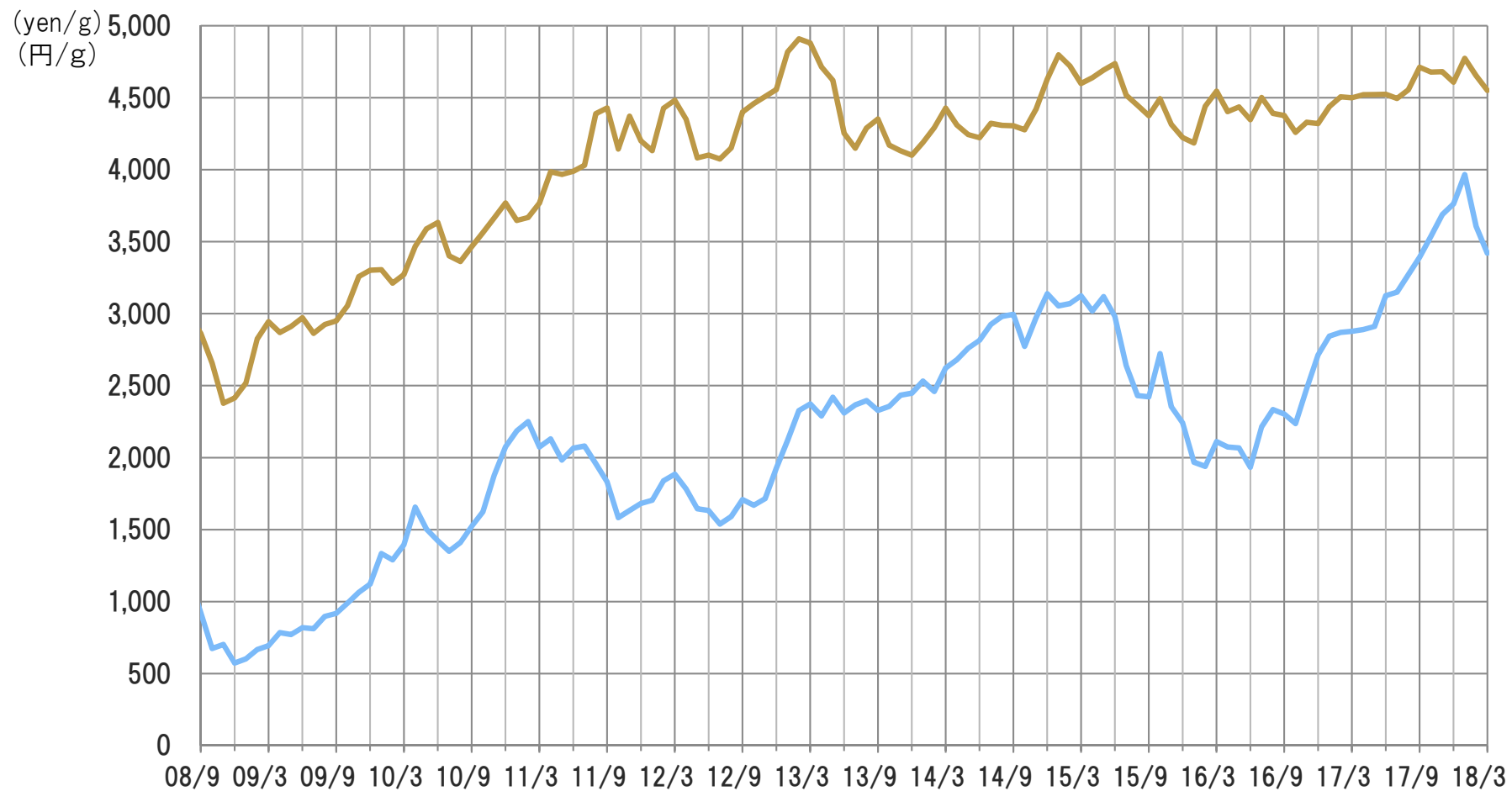
	2017/ 3期	2018/3期						2018/3期予想※	
		1Q	2Q	3Q	4Q	通期合計	増減率		達成率
売上高	8,229	2,360	2,671	2,833	2,803	10,668	29.6	10,400	102.6
営業利益	900	265	286	296	230	1,078	19.8	1,080	99.9
経常利益	1,002	312	290	345	231	1,179	17.6	1,180	100.1
純利益	716	221	201	245	160	829	15.7	830	99.9
1株当たり 当期純利益	124.44円	38.51円	34.97円	42.70円	27.95円	144.13円	—	144.15円	—

※ 2018年3月23日付で業績予想を修正しております。

メタル相場推移

Prices of gold and palladium
金、パラジウム価格

Gold 金
Palladium パラジウム

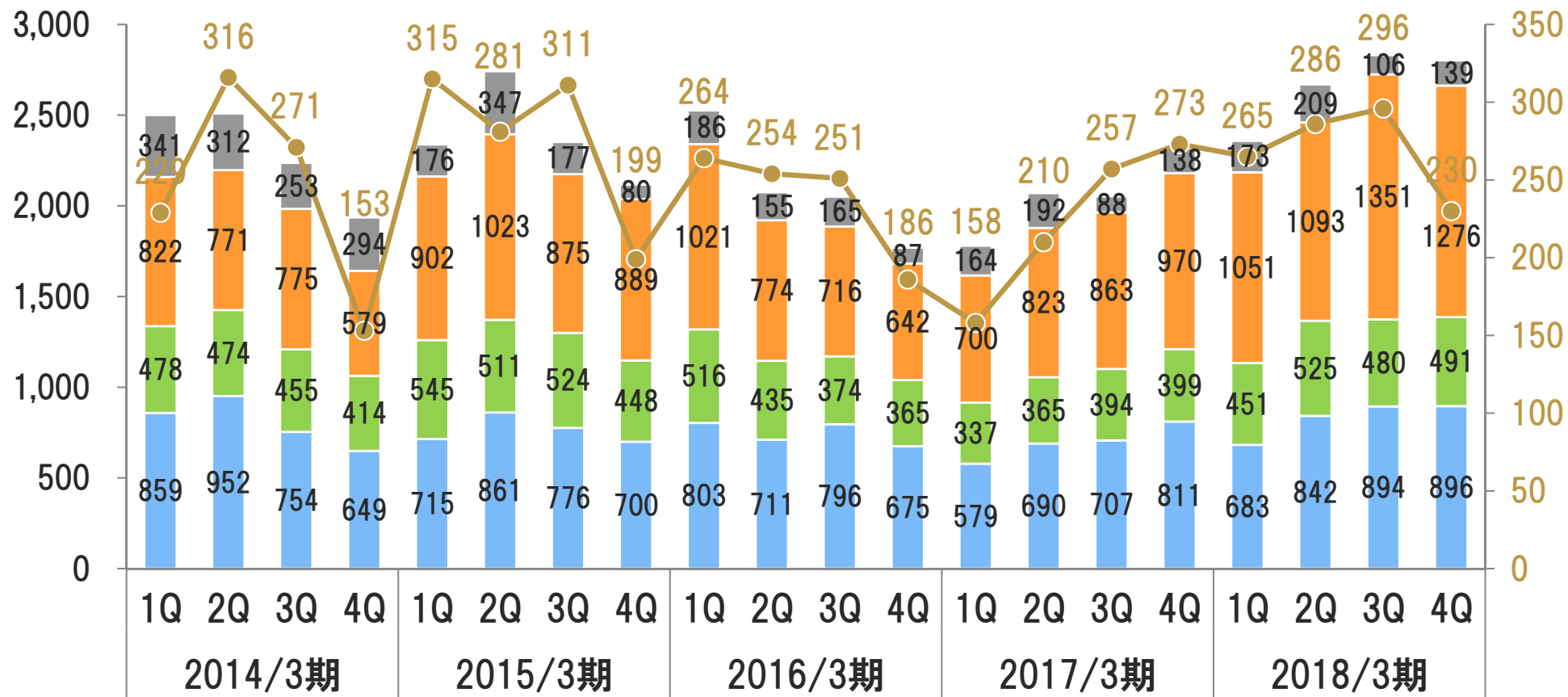


売上高・営業利益の推移(四半期ベース)

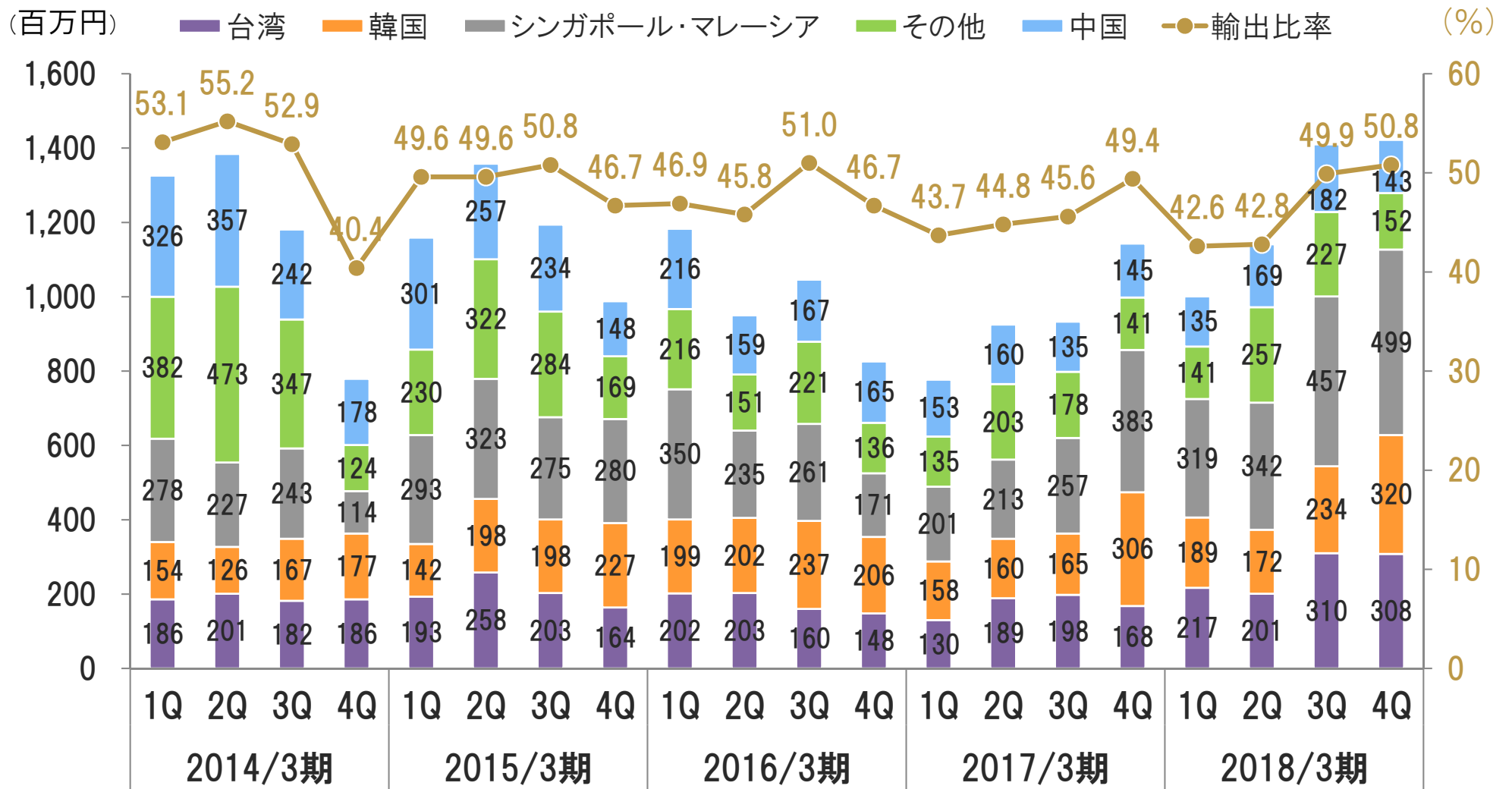
(百万円)

- プリント基板・半導体搭載基板用
- コネクター・マイクロスイッチ用
- リードフレーム用
- その他
- 営業利益

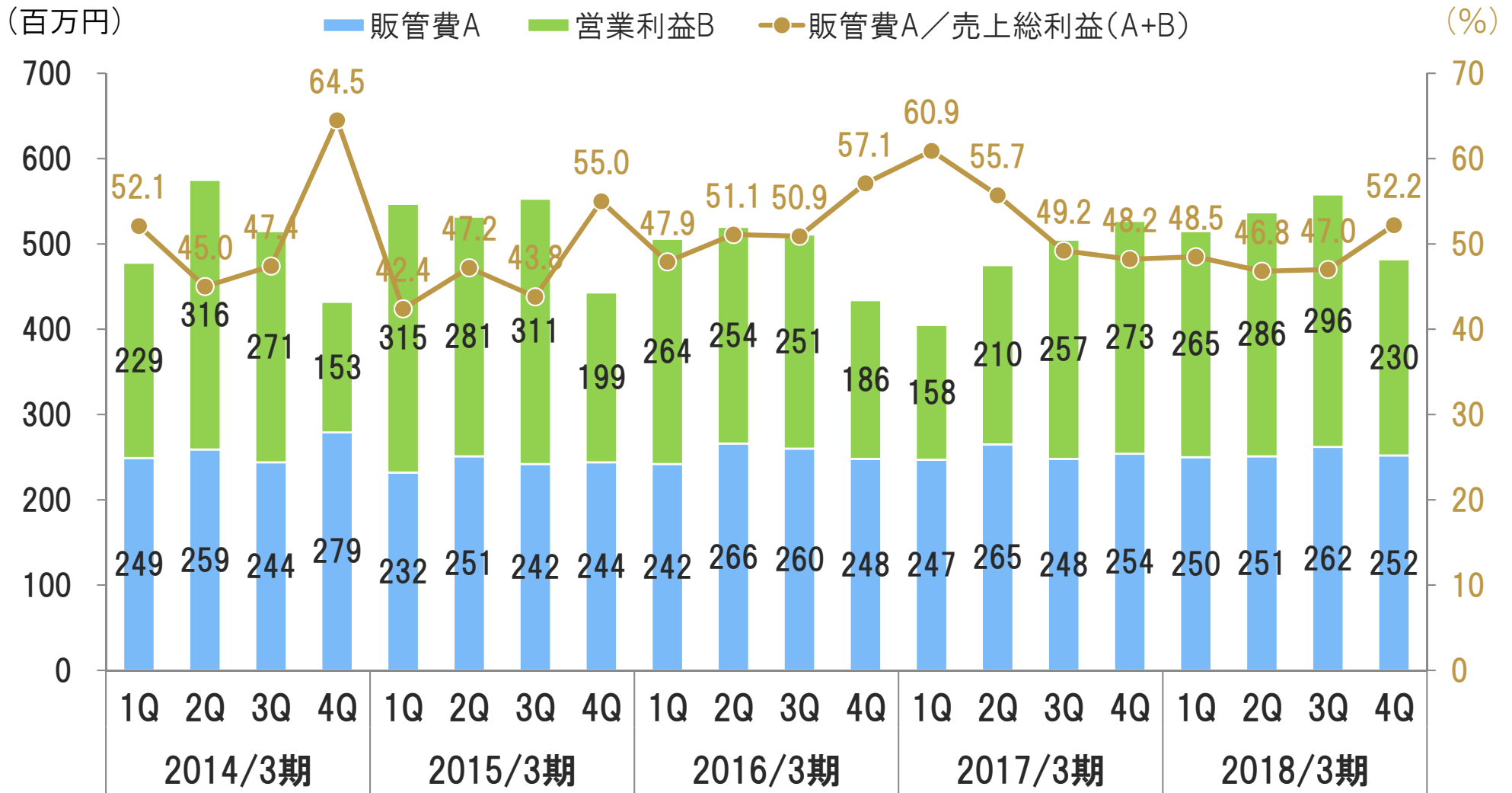
(百万円)



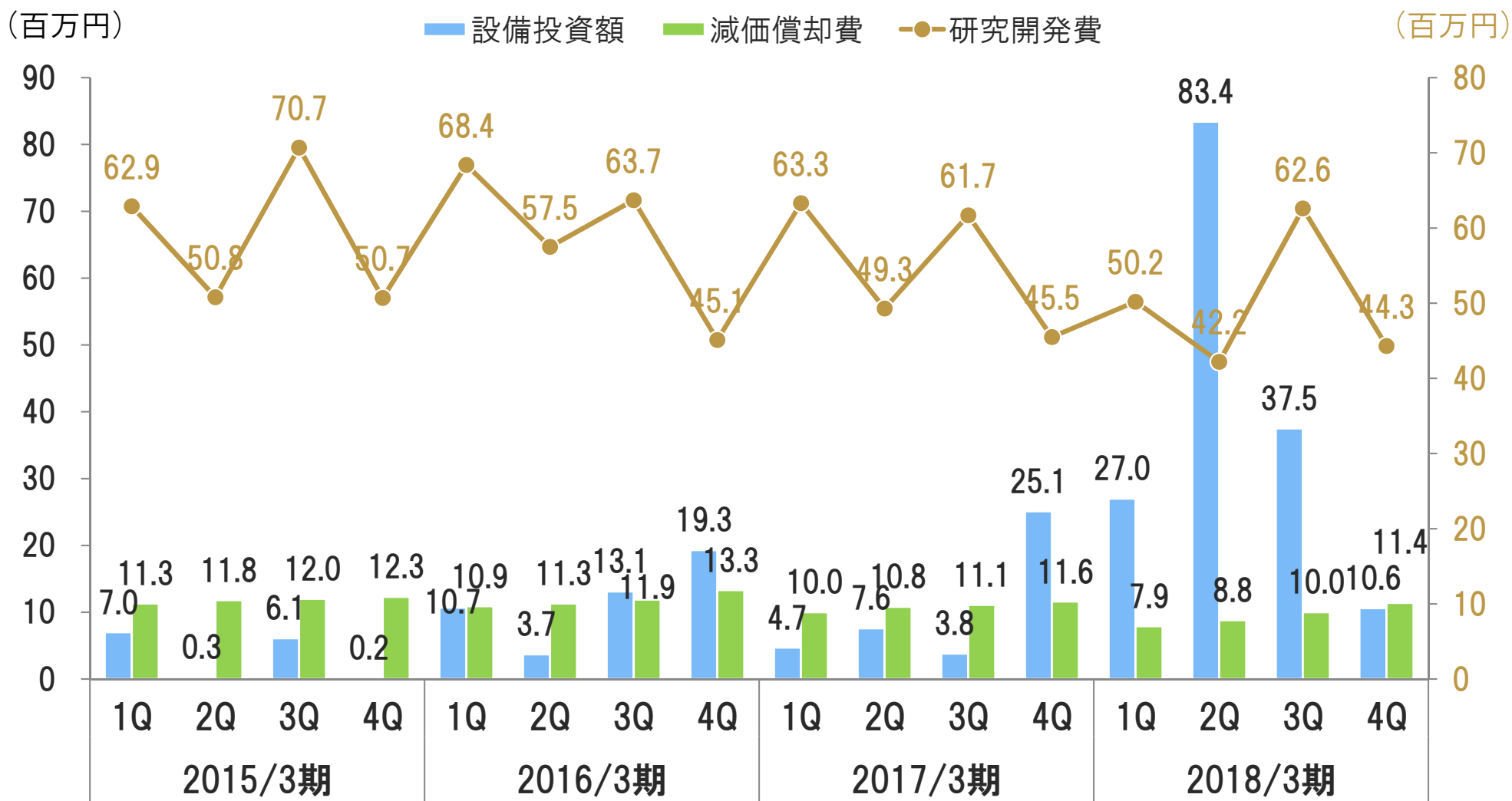
輸出地域別売上高の推移(四半期ベース)



販売管理費および営業利益の推移



設備投資額、減価償却費および研究開発費の推移



※ 研究開発費を財務会計報告に合うよう改変しております。

株主還元について

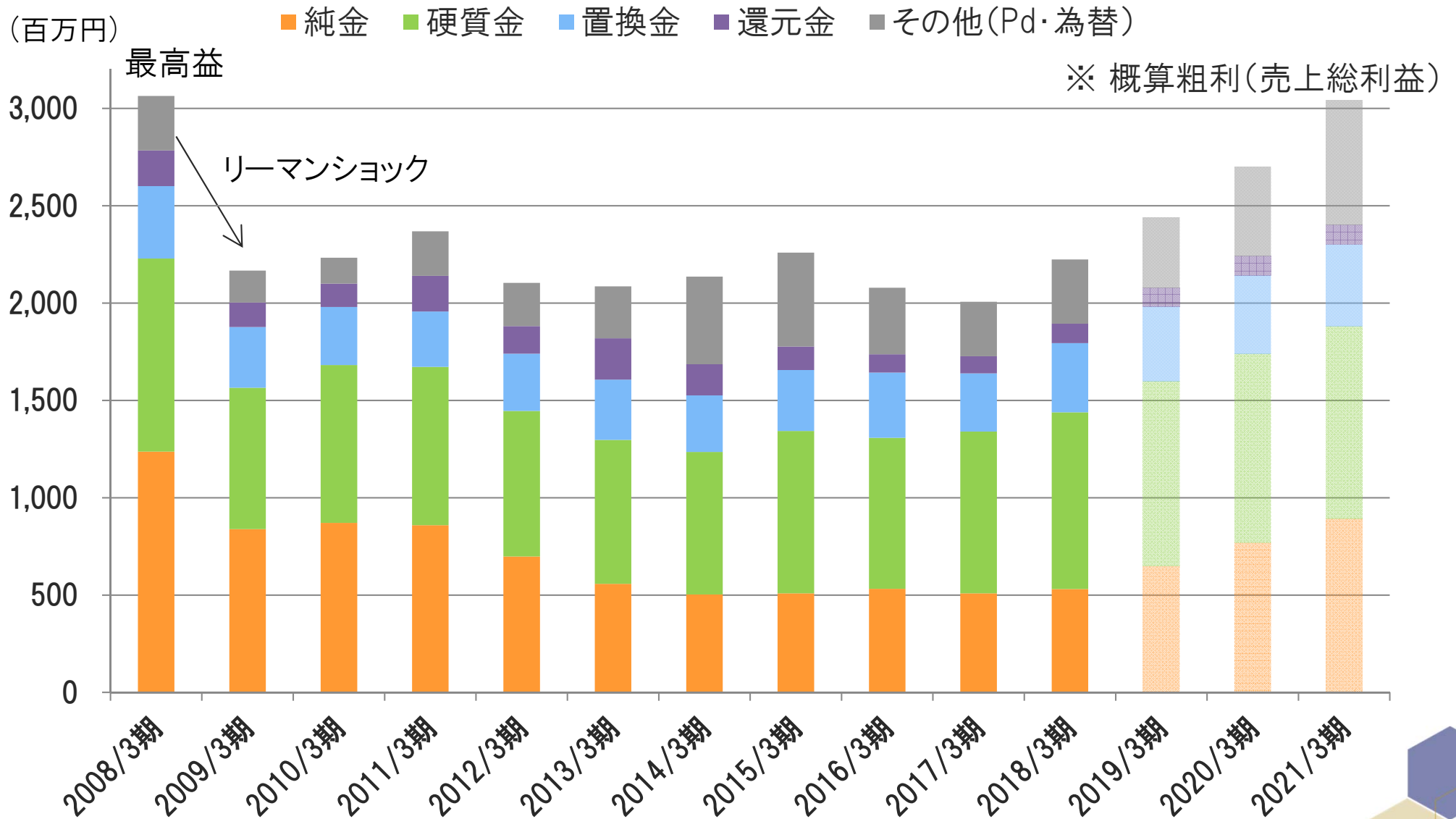
一株当たり配当金

(単位:円、%)

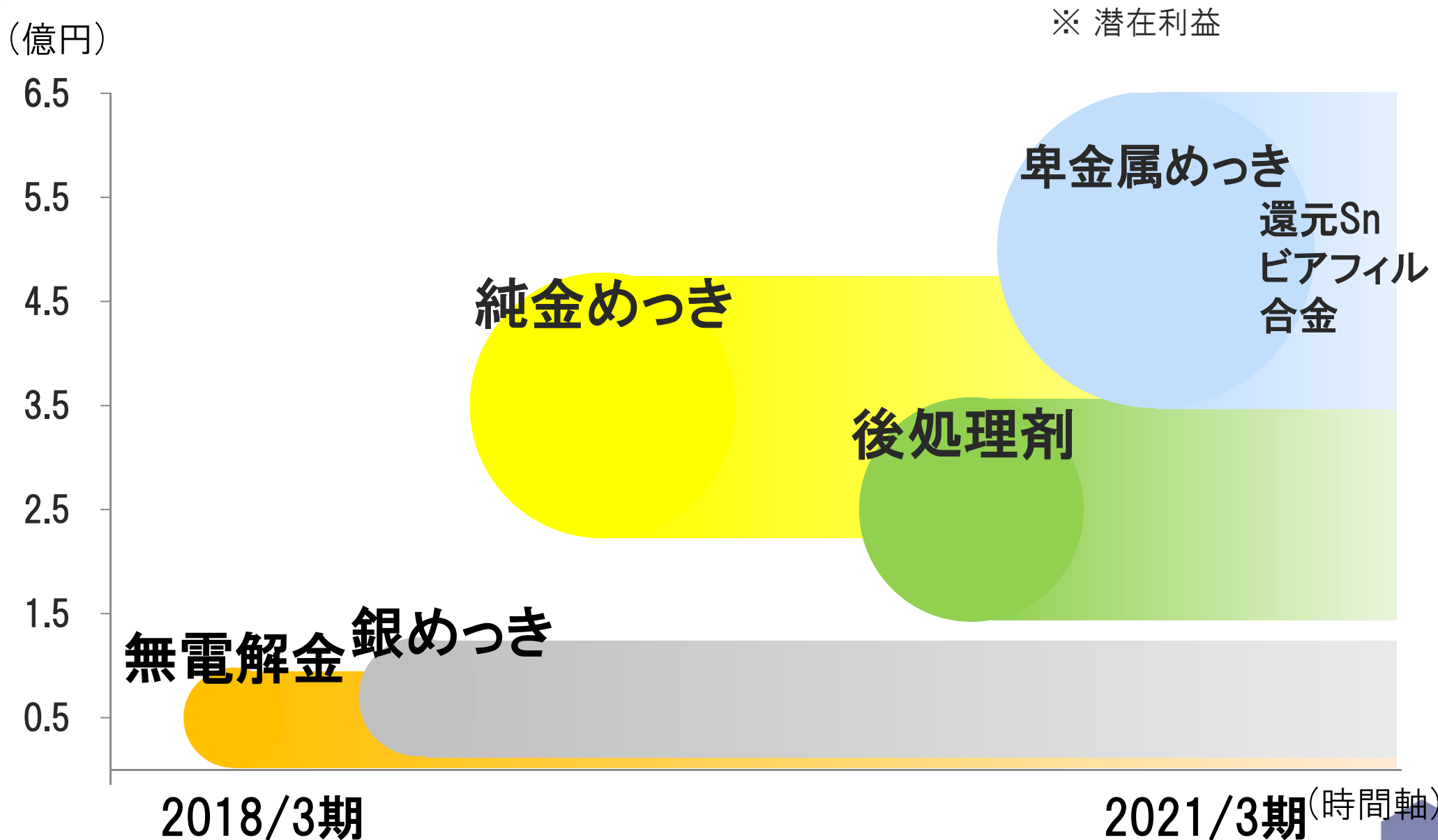
	通期	EPS ※	配当性向
2014/3期	8,000	114.80	69.5
2015/3期	80	131.87	60.7
2016/3期	80	121.31	65.9
2017/3期	80	124.44	64.3
2018/3期	80	144.13	55.5

※ 2014年4月1日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。
そのため、当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり当期純利益を算定しております。

めっき方式別利益計画

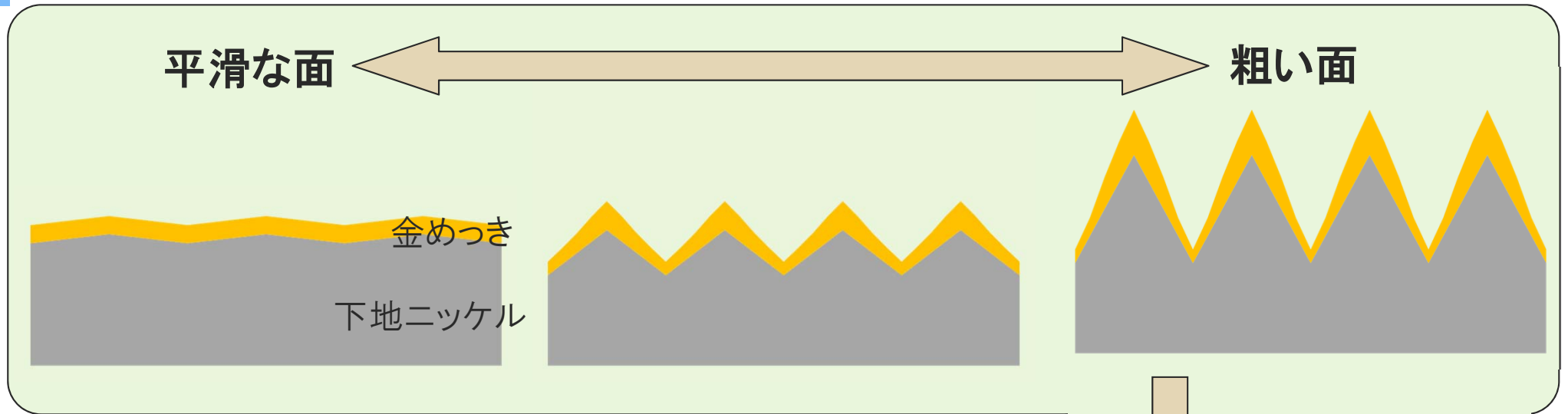


利益貢献が見込まれる新製品群

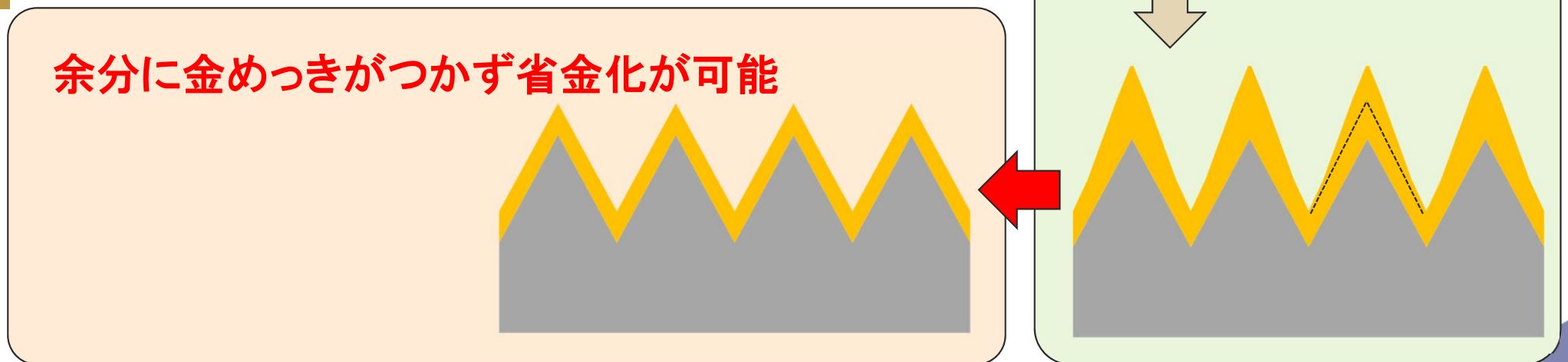


電解純金の省金法 ~めっき膜厚の制御~

従来のめっき液



新しいめっき液

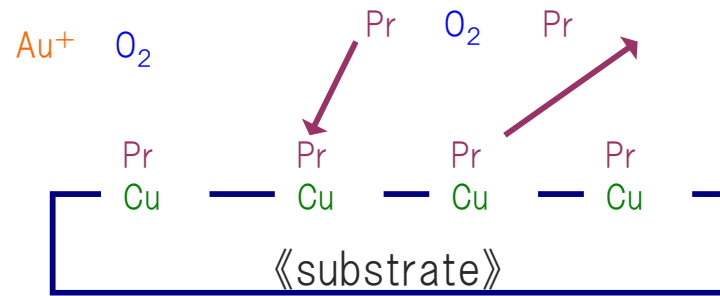


製品ラインアップ ~ラインアップ拡充と新分野開拓~

	めっき方式	用途	製品ラインアップ		
電解	純金		① 粗面上でも均一な膜厚が得られる純金めっき ② 硬度の高い純金めっき		
	硬質金 (金合金)		マイクロコネクタ用省金硬質金めっき オーロブライト BAR7		
	電解Pd		PPF用薄膜パラジウムめっき パラブライト NANO2		
無電解	置換金		低金濃度で使える置換金めっき IM-GOLD FG 下地ニッケルの腐食が少ない置換金めっき IM-GOLD CN		
	還元金		亜硫酸金を使った薄膜還元金めっき HY-GOLD シアン化金を使った薄膜還元金めっき HY-GOLD CN		
	還元Pd		ENEPIG用還元パラジウムめっき ネオパラブライト 2 ダイレクト 還元パラジウムめっき ネオパラブライト DP		
新分野	新分野		後処理剤 合金めっき	還元Snめっき	ビアフィルめっき

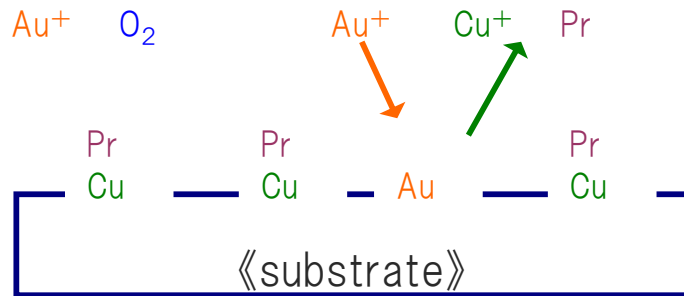
Protecting Agentの作用機構

1



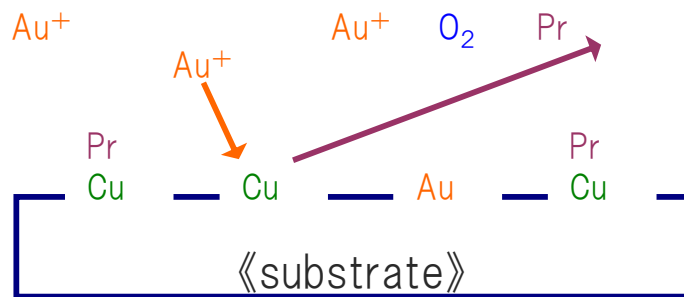
Protecting Agent (Pr) は選択的にCu表面に吸着し、Cu表面の酸化が防止される。

2



Pr が Cu表面から脱離したときにCuとAuの置換反応が起こる。

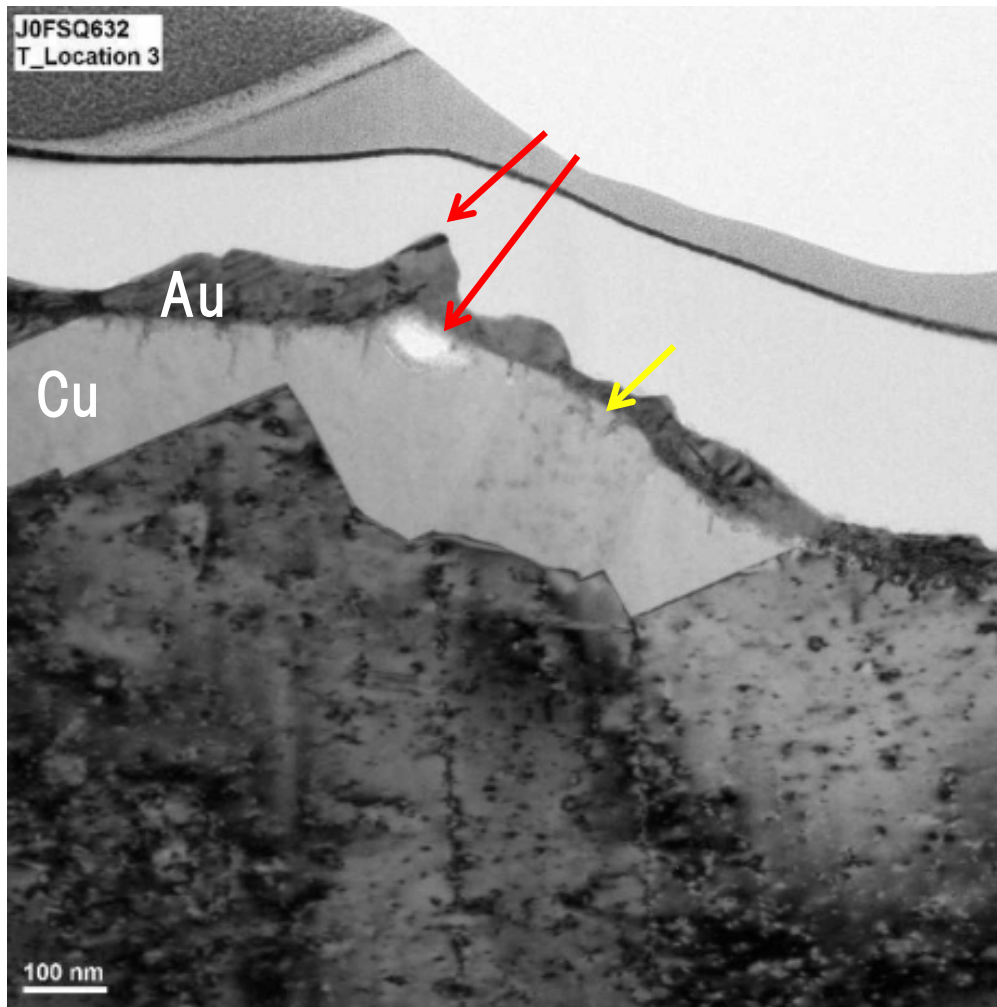
3



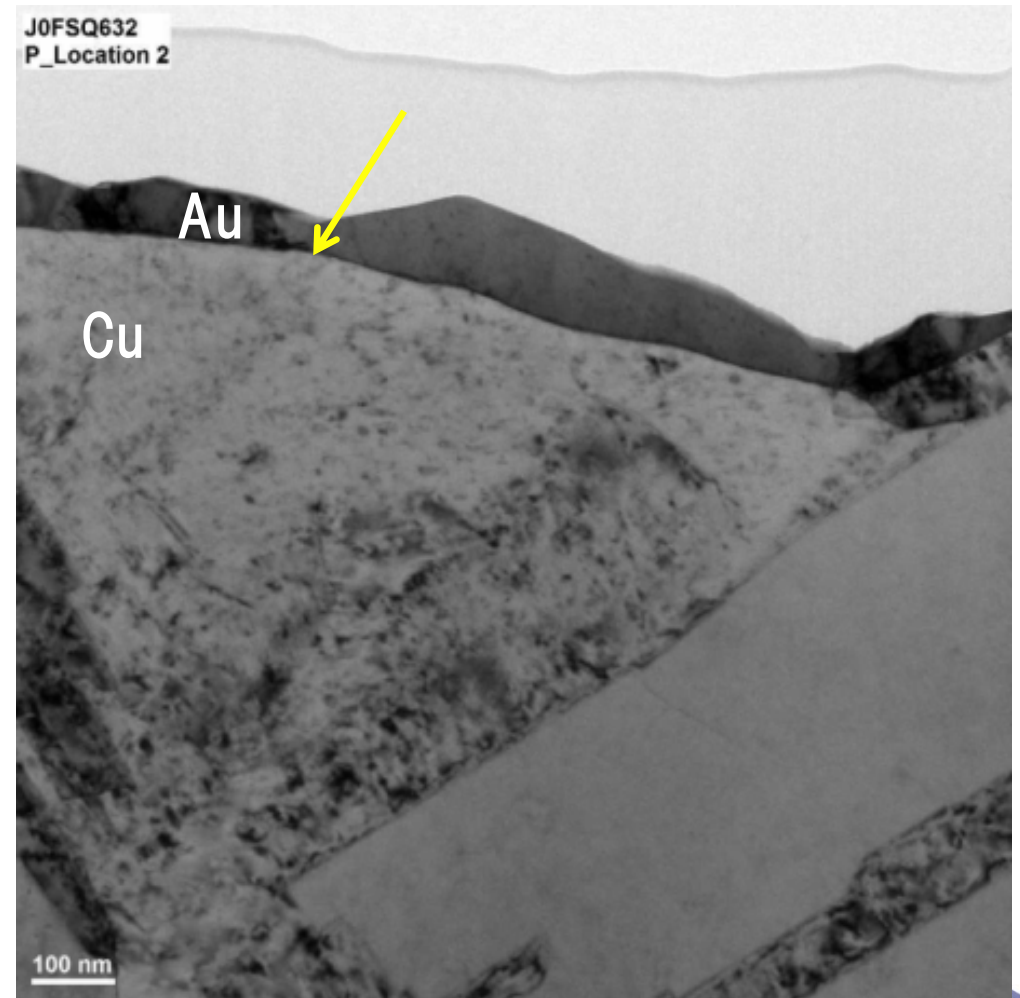
次の Pr分子が脱離すると、そこでCuとAuが置換し、以下同様に反応が進む。
Cu表面が酸化される確率は低い。

ダイレクトめっきの界面の比較

従来のめっき液

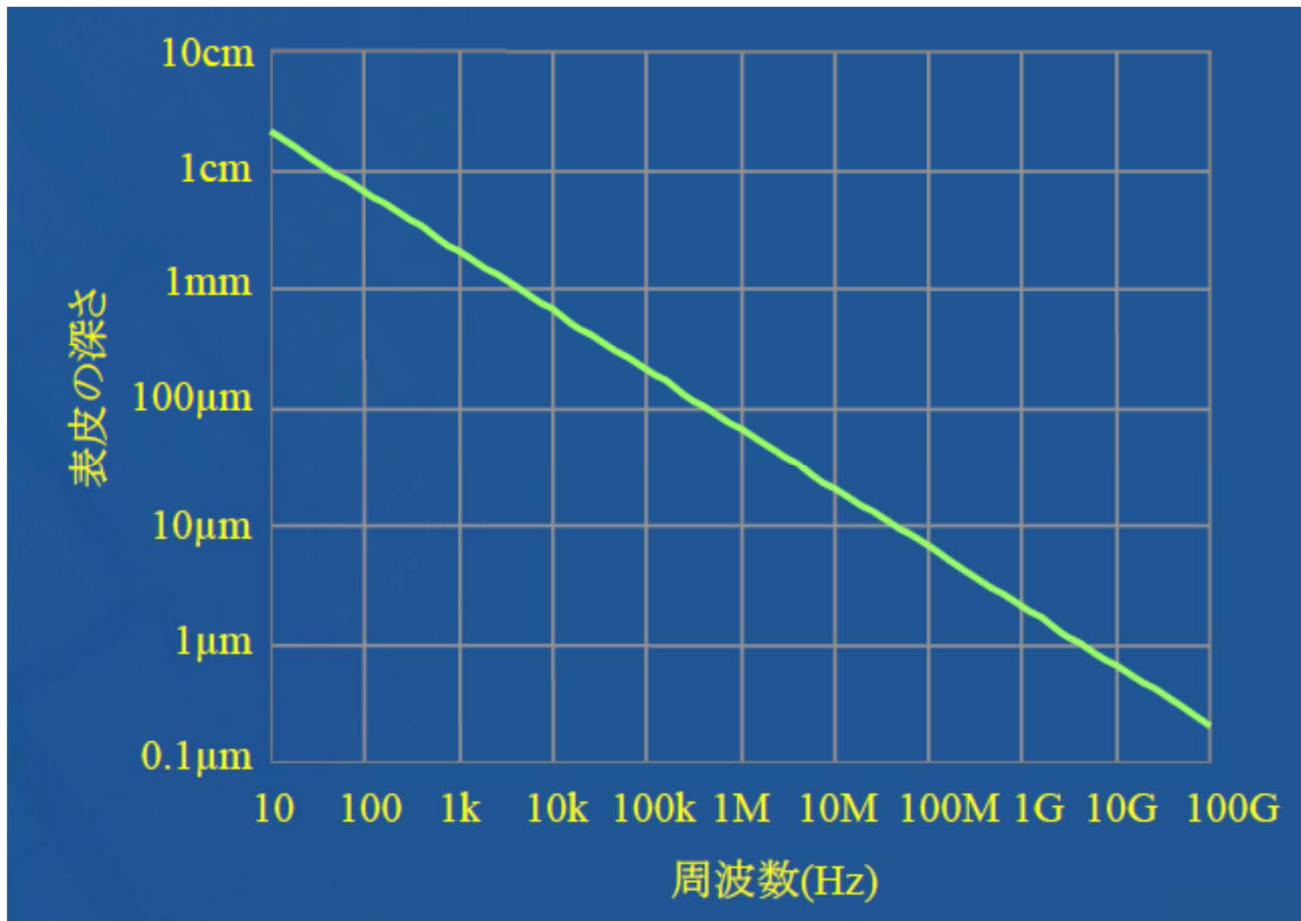


新しいめっき液

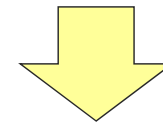


高速伝送に有利なダイレクトめっき

表皮効果



ENEPIG



EPIG



まとめ：開発型企业として新技術の開発を推進

- JPC固有技術であるProtecting Agent(※)の種類を増やし、新しい基板素材との組合せにより“新技術”を提案する。

※特定の金属に選択的に吸着し、電子を供与又は求引する効果によって、めっき反応や皮膜物性をコントロールする一連の有機化合物

- 合金めっき、後処理剤、卑金属めっきなどの“新技術”から次世代の柱となる事業を育成することにより、スマートフォンへの依存度の高い企業体質から脱却する。

通期の見通し

(単位:百万円、%)

	2018/3期		2019/3期			
	構成比	前期比	構成比	前期比		
売上高	10,668	100.0	29.6	10,200	100.0	△4.4
営業利益	1,078	10.1	19.8	1,130	11.1	4.8
経常利益	1,179	11.1	17.6	1,230	12.1	4.3
当期純利益	829	7.8	15.7	860	8.4	3.7

トピックス

- **電解純金めっき**・・・メモリー向け半導体の需要拡大に支えられて好調に推移。さらに拡販を進める
- **DIG(銅上ダイレクト金)**・・・フレキシブル基板市場を中心に拡販するも商業ベースには至らず。
拡販アプローチを模索中
- **EPIG(銅上ダイレクトパラジウム/金)**・・・顧客ライン評価にて進展するも商業ベースには至らず。
巨大なIoT市場に展開できるよう、技術・営業両面でフォロー中

いずれも業界動向や顧客ニーズに迅速に対応できるよう積極的に拡販活動をおこなっております。



注意事項・免責事項

当該資料で用いられている業績予想ならびに将来予測は、いずれも当社の事業に関連する業界の動向についての見通し、国内および諸外国の経済状況、ならびに為替レートの変動、その他の業績へ影響を与える要因について、2018年3月時点で入手可能な情報をもとにした予想を前提としています。

これらは、市況、競争状況、新製品およびサービスの導入およびその成否、ならびに情報通信関連産業の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。よって、実際の業績は配布資料および決算説明で用いる予想数値とは、大きく異なる場合があることをご了解いただきますようお願い致します。

この資料の著作権は日本高純度化学株式会社に帰属します。いかなる理由によっても、当社に許可なく資料を複製・配布することを禁じます。

お問い合わせ先

TEL. 03-3550-1048 FAX. 03-3550-1006

経営企画部

<https://www.netjpc.com>